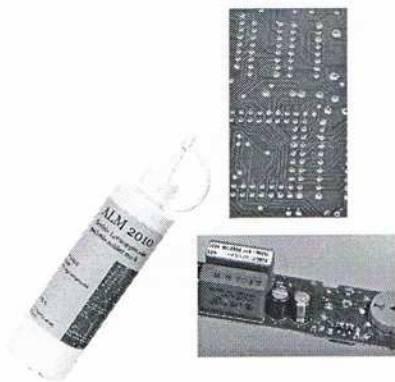


ALM 2010

flexible, ablösbare Lotstoppmaske

peelable soldering mask



Häufig entsteht das Problem bei der Verarbeitung von Klein- und Kleinstserien, daß nicht alle Bereiche der Leiterplatte gelötet oder lackiert werden dürfen. Die EDSYN flexible Lotstoppmaske ALM 2010 hilft bei derartigen Problemen. Es ist ein hoch feststoffhaltiges Latexpolymers für eine vorübergehende Abdeckung. Eine schnelle Trocknung der ALM 2010 ablösbaren Lotstoppmaske von einer Stunde bei 23°C wird bei einer höheren Trocknungstemperatur von bis zu 265°C verkürzt. Sobald die Lotstoppmaske ALM 2010 getrocknet ist, wird die Leiterplatte im Löt- oder Lackierprozeß weiterverarbeitet.

Vorteile

- ausgezeichnete Zugstärke
- gute Klebekraft
- hoher Wärmewiderstand
- geringe Neigung zur Brückenbildung
- Viskosität von annähernd 20.000 cps
- schnelle Trocknung
- leichter Ammoniakgeruch

Technische Daten

- Inhalt der Flasche: 250 cc
- hoher Feststoffgehalt: ca. 60%



Often customers have the problem that on PCB not all area should be soldered or coated. The EDSYN flexible solder mask allows to solve this problem.

It's a high solid content of natural latex for a temporary masking.

The cure rate of ALM 2010 is fast: abt. 1 hour at 23°C. At higher temperature (max. 265°C) the cure time can be shortened.

If the peelable solder mask ALM 2010 is dry, the PCB can be soldered or coated the PCB.

Advantages

- excellent tensile strength
- good adhesion
- high heat resistance
- less tendency for solder bridges
- viscosity approx. 20.000 cps
- quicker drying
- slight ammoniacal odor

Technical Data

- content of bottle: 250cc
- high solid contents of: 60%

